

Technical Data Sheet

FeedBond® EP-1600-S3A

Non-conductive Die Attach Adhesive

產品特色	產品優勢
一液型	無需攪拌 (容易加工)
在光照及高溫下不易黃變	膠不易坍塌及擴散
可作業時間長	操作性佳
中等黏度	適用製程如 pin transfer 及 dispensing 等

產品描述:

FeedBond®EP-1600-S3A為一液型，無色透明矽膠與環氧樹脂混成接著劑，專用於各種光電元件（如：LED）之黏晶膠

應用領域:

FeedBond®EP-1600-S3A 為 Chip LED、GaN LED chip、LED lamp bonding 等應用之黏晶膠，可用於pin transfer and dispensing等製程。

未硬化前性質		測試條件	測試方法
外觀	半透明		目視
黏度 @ 25°C	18,000cps	Brookfield DV-III / CP-51 @ 5rpm	FT-P006
搖變指數 @ 25°C	2.1	Brookfield DV-III / CP-51 Visc. @ 0.5rpm/Visc. @ 5rpm	FT-P008
細度	< 10µm	Grind meter	FT-P026
操作時間@ 25°C	48hrs	黏度增加 25%@ 5rpm	FT-P024
保存時間@ -20°C	6months		FT-P018
硬化條件		測試條件	測試方法
標準硬化條件		60 分鐘 @160°C (烘箱烘烤)	

FeedBond[®] EP-1600-S3A

物理及化學性質		測試條件	測試方法
硬度	85	Durometer Shore D	FT-P037
玻璃轉化溫度 (Tg)	125°C	DMA 阻尼峰，三點彎曲模式	FT-M016
熱膨脹係數 (CTE)		TMA 膨脹模式	FT-M016
低於 Tg(α_1)	55 ppm/°C		
高於 Tg(α_2)	87 ppm/°C		
動態拉伸模數 Dynamic Tensile Modulus		DMA, 試片厚度<1.6mm	FT-M019
@25°C	3764 MPa		
@150°C	1204 MPa		
@250°C	1088 MPa		
硬化後機械性質		測試條件	測試方法
Die Shear Strength @ 25°C	> 2.0 Kg/die	晶片尺寸 45mil × 45mil (銀支架)	FT-M012
@180°C	> 1.0 Kg/die		

使用指導方針

運輸

運送過程皆放入乾冰或低溫冰袋等低溫保存並放置溫度指示劑以確保產品品質。當您收到貨品時發現已無乾冰殘留（或溫度指示劑呈現液態），請立即拍照存證勿使用並立刻通知我司營業人員。

回溫解凍

解凍時，直到完全達室溫時才能使用，請擦乾解凍時凝結在包裝外的水氣；不可反覆解凍及冷凍以防止異常分離現象及氣泡等之產生。

保存

當您收到貨品時，請立即以低溫儲存，由於不同溫度下之保存將影響產品的保存期限。

儲存溫度 Storage Temp.	-22°C~-18°C	0°C~5°C	18°C~28°C
保存期限 Shelf Life	6 個月 6months	3 個月 3months	2 天 2 days

包裝

包裝為依照客戶需求選擇針筒或塑膠罐包裝，如需要詳細資料請聯絡Feedpool客戶服務及銷售部門。